

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-047

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“盛美半导体设备研发与制造中心”、“盛美半导体高端半导体设备研发项目”、“补充流动资金”和“高端半导体设备拓展研发项目”已完成投入或达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目全部结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上述事项无需董事会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

根据《盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2022年8月8日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号: 2022-019)、2023年2月25日披露的《关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的公告》(公告编号: 2023-015)、2023年8月5日披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》(公告编号: 2023-035)、2023年10月28日披露的《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》(公告编号: 2023-043)以及2025年1月11日披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》(公告编号: 2025-004), 公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金
1	盛美半导体设备研发与制造中心	156,890.00	70,000.00	144,500.00
2	盛美半导体高端半导体设备研发项目	45,000.00	45,000.00	45,000.00
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	65,000.00
4	高端半导体设备拓展研发项目	74,773.07	73,087.15	73,087.15
合计		341,663.07	253,087.15	327,587.15

注: 公司于2025年1月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》, 同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”, 并将该项目拟投入的超募资金24,500.00万元变更投入至“盛美半导体设备研发与制造中心”项目。该事项已经2025年2月11日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》(公告编号: 2025-004)。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

公司本次结项的募投项目为“盛美半导体设备研发与制造中心”、“盛美半导体高端半导体设备研发项目”、“补充流动资金”和“高端半导体设备拓展研发项目”, 上述项目已完成投入或达到预定可使用状态, 满足结项条件。截至2025年6月20日, 本次结项募投项目的募集资金具体使用及结余情况如下:

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	调整后拟投入募集资金金额（A）	累计已投入金额（B）	利息及理财收益扣除手续费净额（C）	尚未使用募集资金（D=A-B+C）
1	盛美半导体设备研发与制造中心	156,890.00	144,500.00	125,697.01	255.66	19,058.65
2	盛美半导体高端半导体设备研发项目	45,000.00	45,000.00	45,458.74	458.74	0
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0	0
4	高端半导体设备拓展研发项目	74,773.07	73,087.15	74,434.75	1,347.60	0
合计		341,663.07	327,587.15	310,590.50	2,062.00	19,058.65

注1：累计已投入金额包含募集资金存放期间产生的银行存款利息；

注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

“盛美半导体设备研发与制造中心”项目尚未使用募集资金为该项目需用于支付已签订合同但未到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质保金等款项。项目结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，并按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。待付款项全部结清后，公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2025年6月28日